



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月1日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 竹中 博司

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 経理担当 (氏名) 七澤 豊

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成23年8月9日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	153,117	5.7	23,088	26.0	23,751	24.6	16,636	13.0
23年3月期第1四半期	144,889	110.2	18,321	—	19,063	—	14,727	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 16,772百万円 (68.1%) 23年3月期第1四半期 9,975百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	92.91	92.76
23年3月期第1四半期	82.27	82.15

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	797,368	587,874	72.2
23年3月期	809,205	584,801	70.8

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 575,762百万円 23年3月期 572,741百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	38.00	—	76.00	114.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	45.00	—	22.00	67.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	335,000	5.2	35,000	△17.3	36,000	△20.2	23,000	△31.2	128.44
通期	640,000	△4.3	50,000	△48.9	52,000	△49.0	34,000	△52.7	189.87

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(その他)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(その他)に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

24年3月期1Q	180,610,911 株	23年3月期	180,610,911 株
----------	---------------	--------	---------------

② 期末自己株式数

24年3月期1Q	1,543,571 株	23年3月期	1,554,231 株
----------	-------------	--------	-------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期1Q	179,065,796 株	23年3月期1Q	178,999,952 株
----------	---------------	----------	---------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

・当社は、平成23年8月1日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	4
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	5
2. サマリー情報(その他)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表等	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 継続企業の前提に関する注記	10
(4) セグメント情報等	10
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間の世界経済は、先行きへの警戒感が残るものの、全般的には底堅く推移しました。中国、インドなどの新興国においては引き続き堅調でありましたが、経済成長の勢いに減速感が出始めております。また、日本経済は東日本大震災の影響からの回復の端緒についたところであります。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業に関しましては、スマートフォン等の情報端末機器が引き続き好調に推移しましたが、ここへ来て半導体の需給ギャップは広がってきており、在庫調整の動きが出てきております。

このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1,531億1千7百万円(前年同期比5.7%増)、営業利益230億8千8百万円(前年同期比26.0%増)、経常利益237億5千1百万円(前年同期比24.6%増)、また、四半期純利益は166億3千6百万円(前年同期比13.0%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

半導体メーカー各社の微細化投資継続により、当セグメントの売上は概ね順調に推移しましたが、DRAM等の市況軟化及び半導体メーカーの在庫調整を背景に、受注は低下しました。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1,208億3千6百万円(前年同期比17.1%増)となりました。

② FPD/PV (フラットパネルディスプレイ及び太陽電池) 製造装置

スマートフォン向け等の中小型液晶パネル用製造装置需要は順調に推移しましたが、大型液晶パネル向け需要は低調でした。このような状況のもと、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、125億3千6百万円(前年同期比38.3%減)となりました。

③ 電子部品・情報通信機器

薄型テレビやパソコン等の需要減速及び東日本大震災の影響を受けて、半導体製品の売上は民生機器向けが低調に推移しました。一方、コンピュータ・ネットワーク関連機器の販売は堅調に推移しており、この結果、当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、196億4千8百万円(前年同期比7.8%減)となりました。

④ その他

当セグメントの当第1四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、9千6百万円(前年同期比0.5%増)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
売上高	668,722	144,889	173,510	159,662	190,658	153,117
半導体製造装置	511,331	103,166	137,063	115,373	155,728	120,836
日本	87,940	18,404	28,547	16,927	24,060	20,943
米国	102,898	17,552	22,474	20,974	41,897	29,756
欧州	28,482	2,942	7,028	5,609	12,902	13,999
韓国	87,858	21,445	30,126	17,092	19,194	16,926
台湾	150,282	34,014	37,082	35,383	43,802	24,705
中国	25,593	4,649	5,195	7,960	7,787	9,115
東南アジア他	28,275	4,158	6,608	11,424	6,084	5,390
F P D / P V 製造装置	66,721	20,306	12,553	21,992	11,867	12,536
電子部品・情報通信機器	90,216	21,321	23,754	22,222	22,917	19,648
その他	453	95	138	73	145	96
営業利益	97,870	18,321	24,020	25,815	29,713	23,088
経常利益	101,919	19,063	26,043	26,667	30,145	23,751
四半期(当期)純利益	71,924	14,727	18,726	18,667	19,802	16,636

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	507,161	109,682	128,388	142,537	126,553	127,147
F P D / P V 製造装置	74,016	16,851	21,103	15,090	20,970	14,115
合計	581,177	126,534	149,491	157,628	147,523	141,262

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績 (受注高)

(単位：百万円)

	前期通期					当期第1Q
	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q		
半導体製造装置	567,971	133,205	150,278	128,631	155,856	112,692
F P D / P V 製造装置	75,433	11,453	22,438	15,234	26,307	8,920
電子部品・情報通信機器	91,035	24,958	22,644	21,455	21,977	22,508
その他	453	95	138	73	145	96
合計	734,893	169,712	195,500	165,395	204,285	144,217

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績 (受注残高)

(単位: 百万円)

	前期第1Q	前期第2Q	前期第3Q	前期第4Q	当期第1Q
半導体製造装置	202,342	215,557	228,815	228,942	220,798
F P D / P V 製造装置	47,924	57,809	51,051	65,491	61,875
電子部品・情報通信機器	17,193	16,082	15,315	14,375	17,235
その他	—	—	—	—	—
合 計	267,460	289,449	295,182	308,809	299,909

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態

当第1四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ121億7千万円減少の6,320億6千万円となりました。主な内容は、未収消費税等の減少146億9千1百万円、受取手形及び売掛金の減少116億2千8百万円、たな卸資産の増加141億6千3百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から6億8千9百万円増加し、1,132億4千1百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から1億9千6百万円減少し、40億1千6百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から1億5千8百万円減少し、480億5千万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から118億3千6百万円減少の7,973億6千8百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ161億6千7百万円減少の1,518億7千万円となりました。主な内容は、未払法人税等の減少212億1百万円であります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ12億5千7百万円増加の576億2千2百万円となりました。

純資産は、四半期純利益166億3千6百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当136億8百万円の実施による減少の結果、5,878億7千4百万円となり、また自己資本比率は72.2%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ548億6千5百万円減少し、1,101億8千4百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない預入期間3ヶ月超の定期預金及び譲渡性預金1,740億円を加えた残高は、2,841億8千4百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ81億7千3百万円増加の180億3千8百万円となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益234億2千3百万円、未収消費税等の減少146億8千8百万円、売上債権の減少114億1千2百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額277億4千4百万円、たな卸資産の増加156億5千万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出41億1千2百万円、定期預金及び譲渡性預金の純増加額540億円により、前年同期の44億4千1百万円に対し587億4千8百万円となりました。

財務活動により支出したキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払136億8百万円により、前年同期の37億1千5百万円に対し142億9百万円となりました。

【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第1四半期 連結累計期間	当第1四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,864	18,038
税金等調整前四半期純利益	19,250	23,423
減価償却費	3,726	4,744
売上債権の増減額(△は増加)	△6,786	11,412
たな卸資産の増減額(△は増加)	△14,490	△15,650
仕入債務の増減額(△は減少)	2,756	686
その他	5,407	△6,578
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,441	△58,748
定期預金の増減額(△は増加)	—	△54,000
その他(固定資産の取得等)	△4,441	△4,748
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,715	△14,209
現金及び現金同等物に係る換算差額	△925	53
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	782	△54,865
現金及び現金同等物の期首残高	123,939	165,050
現金及び現金同等物の四半期末残高	124,721	110,184
現金及び現金同等物並びに3か月超の定期預金等の 四半期末残高	244,721	284,184

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

スマートフォン、タブレットPCなどの在庫調整の影響で、半導体デバイスの価格が下落し、半導体メーカーの設備投資もここへ来て急速に抑制の動きが強まっております。このような状況を受け、第2四半期連結累計期間の連結業績予想に変更はないものの、下半期の半導体製造装置部門の売上が前回予想を下回る見通しとなったことにより、平成23年5月13日に公表した通期の連結業績予想を修正いたします。

平成24年3月期の連結業績予想

	第2四半期連結累計期間	通 期
売上高	3,350億円 (前年同期比 5.2%増)	6,400億円 (前年同期比 4.3%減)
半導体製造装置	2,530億円 (前年同期比 5.3%増)	4,700億円 (前年同期比 8.1%減)
FPD/PV製造装置	380億円 (前年同期比15.6%増)	750億円 (前年同期比12.4%増)
電子部品・情報通信機器	440億円 (前年同期比 2.4%減)	950億円 (前年同期比 5.3%増)
営業利益	350億円 (前年同期比17.3%減)	500億円 (前年同期比48.9%減)
経常利益	360億円 (前年同期比20.2%減)	520億円 (前年同期比49.0%減)
当期(四半期)純利益	230億円 (前年同期比31.2%減)	340億円 (前年同期比52.7%減)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社グループが合理的であると判断した一定の前提に基づいております。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

当第1四半期連結会計期間より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6月30日)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成22年6月30日)を適用しております。

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。

これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の金額は、82円12銭であります。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	52,992	50,184
受取手形及び売掛金	136,385	124,756
有価証券	232,057	234,000
商品及び製品	111,918	124,366
仕掛品	43,246	43,574
原材料及び貯蔵品	13,760	15,148
その他	55,024	41,101
貸倒引当金	△1,153	△1,071
流動資産合計	644,231	632,060
固定資産		
有形固定資産	112,551	113,241
無形固定資産		
その他	4,212	4,016
無形固定資産合計	4,212	4,016
投資その他の資産		
その他	50,240	50,075
貸倒引当金	△2,031	△2,024
投資その他の資産合計	48,209	48,050
固定資産合計	164,973	165,307
資産合計	809,205	797,368
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	53,612	54,167
その他の引当金	19,401	12,757
その他	95,024	84,945
流動負債合計	168,038	151,870
固定負債		
退職給付引当金	52,230	52,883
その他の引当金	595	600
その他	3,538	4,138
固定負債合計	56,365	57,622
負債合計	224,403	209,493
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,045	78,035
利益剰余金	457,658	460,686
自己株式	△10,484	△10,412
株主資本合計	580,180	583,270
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,807	3,142
繰延ヘッジ損益	△12	11
為替換算調整勘定	△10,234	△10,662
その他の包括利益累計額合計	△7,439	△7,508
新株予約権	1,499	1,516
少数株主持分	10,560	10,596
純資産合計	584,801	587,874
負債純資産合計	809,205	797,368

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
売上高	144,889	153,117
売上原価	95,742	94,646
売上総利益	49,146	58,470
販売費及び一般管理費		
研究開発費	14,836	18,176
その他	15,988	17,204
販売費及び一般管理費合計	30,825	35,381
営業利益	18,321	23,088
営業外収益		
補助金収入	474	278
その他	411	563
営業外収益合計	886	842
営業外費用		
為替差損	54	63
閉鎖拠点維持管理費用	56	44
その他	32	71
営業外費用合計	144	179
経常利益	19,063	23,751
特別利益		
償却債権取立益	—	1,437
貸倒引当金戻入額	310	—
その他	12	41
特別利益合計	322	1,478
特別損失		
災害による損失	—	980
投資有価証券評価損	—	800
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	42	—
その他	93	26
特別損失合計	135	1,806
税金等調整前四半期純利益	19,250	23,423
法人税等	4,392	6,592
少数株主損益調整前四半期純利益	14,857	16,831
少数株主利益	130	195
四半期純利益	14,727	16,636

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	14,857	16,831
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,666	334
繰延ヘッジ損益	221	44
為替換算調整勘定	△3,437	△437
その他の包括利益合計	△4,882	△58
四半期包括利益	9,975	16,772
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	9,807	16,566
少数株主に係る四半期包括利益	167	205

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD/PV(フラットパネルディスプレイ及び太陽電池)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD/PV製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置及び薄膜シリコン太陽電池用のプラズマCVD装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD/PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	120,836	12,536	20,022	3,961	157,356	△4,239	153,117
セグメント利益	28,330	859	735	605	30,530	△7,106	23,423

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの製品等の輸送、機器等のリース及び保険業務等を含んでおります。

2. セグメント利益の調整額△7,106百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△6,032百万円であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。